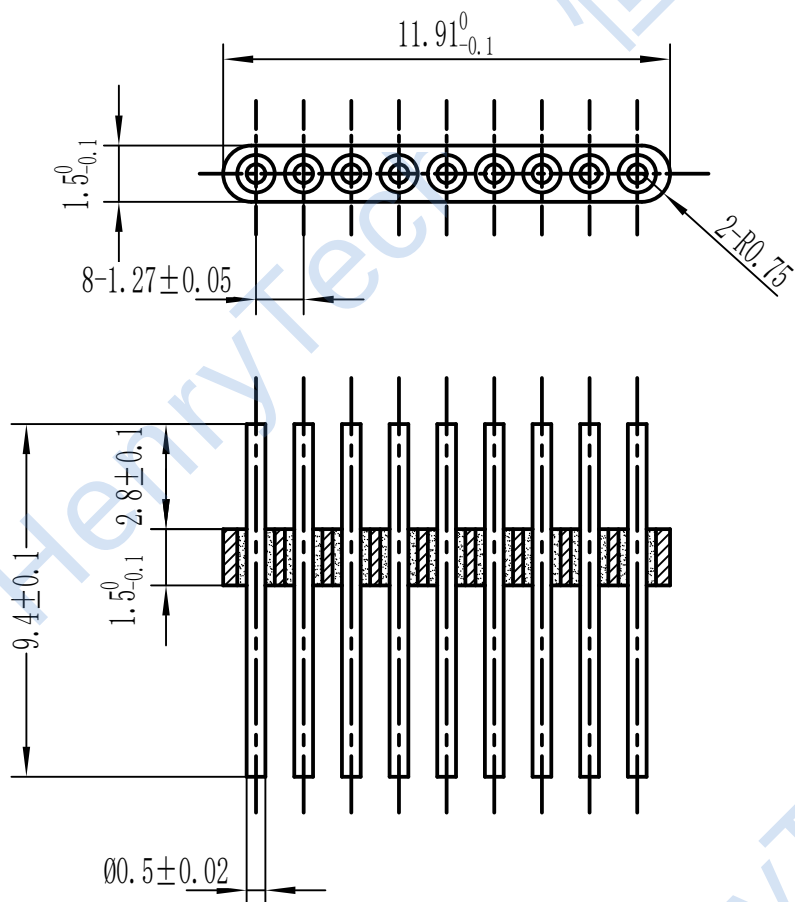




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP9-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M.	标准化		
审核				
工艺		日期		

图样标记

重量

比例

1:1

共 页

第 页